



<b>Title of Change:</b>	Transfer of Die Sales Products in Waffle Pack and Reel Sales manufacturing from Amkor subcontractor to ON Semiconductor Seremban a qualified site for this business.	
<b>Proposed first ship date:</b>	18 October 2019 or earlier after customer approval	
<b>Contact information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <muhammadfahmi.mohdfaudzi@onsemi.com>	
<b>Samples:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
<b>Additional Reliability Data:</b>	N/A	
<b>Type of notification:</b>	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
<b>Change Part Identification:</b>	Change parts will be identified by the new plant code.	
<b>Change Category:</b>	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
<b>Change Sub-Category(s):</b>	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
<b>Sites Affected:</b>	ON Semiconductor Sites: ON Seremban, Malaysia	External Foundry/Subcon Sites: Amkor Phil 1
<b>Description and Purpose:</b>		
Reason for Change: EOL in AMKOR PHILIPPINES in Wk19 2019.		
	<b>From</b>	<b>To</b>
DPS Location Change	AMKOR PHIL	ON SEREMBAN, MALAYSIA
There are no product material changes nor product marking change as a result of this change.		
<b>Reliability Data Summary:</b> N/A		
<b>Electrical Characteristic Summary:</b> Electrical characteristics are not impacted		
<b>List of Affected Parts:</b>		
<b>Note:</b> Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the <b>PCN Customized Portal</b> .		
<b>Part Number</b>	<b>Qualification Vehicle</b>	
B300W35A109XXG	B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G	
BR262W26A103E1G	B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G	
B300W35A109A1G	B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G	

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22691X

発行日 : 11 July 2019

変更件名:	DPS 製造の Amkor 外注工場から当該ビジネス認定済み拠点のオン・セミコンダクター、セレンバンへの移管									
初回出荷予定日:	18 October 2019 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)									
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <muhammadfahmi.mohdfaudzi@onsemi.com> にお問い合わせください。									
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。									
追加の信頼性データ:	該当なし									
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。									
変更部品の識別:	変更品は新しい工場コードにより識別されます。									
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他									
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____									
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Seremban, Malaysia	外部製造工場 / 下請業者拠点: Amkor Phil 1								
説明および目的:	<p>変更の理由: AMKOR PHILIPPINES における EOL (2019 年第 19 週)。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPS 場所の変更</td> <td>AMKOR PHIL</td> <td>オン セレンバン (マレーシア)</td> </tr> </tbody> </table> <p>今回の変更に伴う製品材料および製品マーキングの変更はありません。</p>			変更前	変更後	DPS 場所の変更	AMKOR PHIL	オン セレンバン (マレーシア)		
	変更前	変更後								
DPS 場所の変更	AMKOR PHIL	オン セレンバン (マレーシア)								
信頼性データの要約:	該当なし									
電気的特性の要約:	電気的特性への影響はありません。									
影響を受ける部品の一覧:	<p>注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品番号</th> <th>認定試験用ピークル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B300W35A109XXG</td> <td>B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G</td> </tr> <tr> <td>BR262W26A103E1G</td> <td>B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G</td> </tr> <tr> <td>B300W35A109A1G</td> <td>B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G</td> </tr> </tbody> </table>		部品番号	認定試験用ピークル	B300W35A109XXG	B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G	BR262W26A103E1G	B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G	B300W35A109A1G	B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G
部品番号	認定試験用ピークル									
B300W35A109XXG	B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G									
BR262W26A103E1G	B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G									
B300W35A109A1G	B300W35A109A1G/BR262W26A103E1G									



---

## Appendix A: Changed Products

---

D

---

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
B300W35A109XXG		B300W35A109A1G/ BR262W26A103E1G